

2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年8月6日
東

上場会社名 株式会社メイコー 上場取引所
コード番号 6787 URL <https://www.meiko-elec.com/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 名屋 佑一郎
問合せ先責任者 (役職名) 経理本部長 (氏名) 船山 淳 (TEL) 0467-76-6001
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	47,013	13.0	3,265	260.0	4,394	50.3	3,053	35.0
2024年3月期第1四半期	41,588	3.9	907	△67.7	2,923	△43.6	2,262	△42.8

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 10,041百万円(28.9%) 2024年3月期第1四半期 7,791百万円(△30.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第1四半期	116.01	—
2024年3月期第1四半期	85.15	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第1四半期	251,179	113,783	42.4
2024年3月期	229,960	105,458	42.7

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 106,545百万円 2024年3月期 98,184百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	27.00	—	41.00	68.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	36.00	—	36.00	72.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当状況については、後述の「(参考)種類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	195,000	8.7	16,000	37.2	15,000	5.1	12,500	10.5	475.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 一社(社名) — 、除外 一社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料7ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2025年3月期1Q	26,803,320株	2024年3月期	26,803,320株
2025年3月期1Q	1,154,217株	2024年3月期	1,156,117株
2025年3月期1Q	25,648,602株	2024年3月期1Q	25,644,432株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として保有する当社株式が含まれております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 経営成績等の概況(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(参考)種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は、以下のとおりであります。

第一回社債型種類株式	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2024年3月期	円 銭 —	円 銭 2,256,164.40	円 銭 —	円 銭 2,256,164.40	円 銭 4,512,328.80
2025年3月期	円 銭 —				
2025年3月期(予想)		円 銭 2,256,164.40	円 銭 —	円 銭 2,243,835.60	円 銭 4,500,000.00

(注) 上記の第一回社債型種類株式の発行数は70株であり、2022年10月25日に発行しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における電子部品業界は、世界的にインフレや金利上昇が一段落しつつあるものの、地政学的な緊張、金融政策の変化など依然として先行きの不透明が続く中、緩やかな回復にとどまりました。

このような状況の中当社グループの売上は、車載向け基板は電動車の減速や中国市場での日系自動車の販売不振等があったものの総じて堅調に推移しました。スマートフォン向け基板、SSD・IoTモジュール向け基板は好調に推移しました。また当期より衛星通信向け基板の量産を開始いたしました。EMS事業は受託開発案件が堅調に推移しました。利益面では、半導体パッケージ基板が生産の遅れから赤字となっているものの、多層貫通基板及びビルドアップ基板の受注拡大に伴って工場稼働率が向上しており、コスト削減や為替の影響等と相まって前年同期比増益となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、47,013百万円（前年同期比13.0%増）と前年同期に比べ5,424百万円の増収となりました。損益面では、営業利益が3,265百万円（前年同期比260.0%増）、経常利益が4,394百万円（前年同期比50.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が3,053百万円（前年同期比35.0%増）となりました。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

(資産)

当第1四半期連結会計期間末の資産は251,179百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,219百万円増加しました。流動資産において、現金及び預金が3,475百万円増加、受取手形及び売掛金が2,211百万円増加、電子記録債権が1,118百万円増加、棚卸資産が4,397百万円増加、流動資産のその他が1,924百万円増加、固定資産において、有形固定資産が5,993百万円増加、投資その他の資産が2,268百万円増加が主な要因であります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末の負債は137,395百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,894百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が3,165百万円増加、短期借入金が9,926百万円増加、流動負債のその他が1,273百万円増加、固定負債において、長期借入金が949百万円減少が主な要因であります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産は113,783百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,324百万円増加しました。資本剰余金が421百万円減少、利益剰余金が1,830百万円増加、為替換算調整勘定が6,857百万円増加が主な要因であります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年3月期の連結業績予想につきましては、2024年5月10日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,602	25,077
受取手形及び売掛金	37,787	39,998
電子記録債権	3,331	4,449
商品及び製品	9,997	11,586
仕掛品	7,972	8,745
原材料及び貯蔵品	17,624	19,659
その他	4,550	6,475
貸倒引当金	△26	△28
流動資産合計	102,839	115,964
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	37,468	41,508
機械装置及び運搬具（純額）	48,987	54,440
土地	2,547	2,547
建設仮勘定	19,223	14,623
その他（純額）	3,839	4,938
有形固定資産合計	112,065	118,059
無形固定資産		
のれん	5,627	5,458
その他	790	792
無形固定資産合計	6,418	6,250
投資その他の資産	8,636	10,904
固定資産合計	127,120	135,215
資産合計	229,960	251,179

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	27,032	30,197
短期借入金	32,212	42,139
1年内返済予定の長期借入金	9,524	9,449
未払法人税等	1,106	1,038
賞与引当金	1,304	612
役員賞与引当金	59	0
その他	10,475	11,748
流動負債合計	81,714	95,187
固定負債		
長期借入金	37,250	36,300
役員退職慰労引当金	215	215
株式給付引当金	414	295
役員株式給付引当金	56	58
退職給付に係る負債	3,598	3,558
その他	1,251	1,778
固定負債合計	42,786	42,207
負債合計	124,501	137,395
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	14,242	13,820
利益剰余金	45,146	46,976
自己株式	△2,710	△2,703
株主資本合計	69,566	70,982
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	94	109
繰延ヘッジ損益	45	115
為替換算調整勘定	28,467	35,325
退職給付に係る調整累計額	10	11
その他の包括利益累計額合計	28,617	35,562
非支配株主持分	7,274	7,238
純資産合計	105,458	113,783
負債純資産合計	229,960	251,179

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日)
売上高	41,588	47,013
売上原価	35,409	39,010
売上総利益	6,179	8,002
販売費及び一般管理費	5,272	4,736
営業利益	907	3,265
営業外収益		
受取利息	108	197
受取配当金	4	8
為替差益	2,156	1,210
その他	64	81
営業外収益合計	2,334	1,498
営業外費用		
支払利息	282	300
その他	35	69
営業外費用合計	318	369
経常利益	2,923	4,394
特別利益		
固定資産売却益	2	22
特別利益合計	2	22
特別損失		
固定資産除売却損	4	29
特別損失合計	4	29
税金等調整前四半期純利益	2,921	4,387
法人税等	639	1,290
四半期純利益	2,281	3,096
非支配株主に帰属する四半期純利益	19	42
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,262	3,053

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純利益	2,281	3,096
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	33	14
繰延ヘッジ損益	△180	70
為替換算調整勘定	5,650	6,857
退職給付に係る調整額	6	1
その他の包括利益合計	5,509	6,944
四半期包括利益	7,791	10,041
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,761	9,998
非支配株主に係る四半期包括利益	29	42

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報等の注記)

当社グループは、電子回路基板等の設計、製造販売及びこれらの付随業務の電子関連事業を主とし、その他の事業については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、当第1四半期連結会計期間に連結子会社であるMeiko Electronics Hai Duong Vietnam Co., Ltd.の株式を非支配株主から追加取得いたしました。この結果、当第1四半期連結累計期間において、資本剰余金が421百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が13,820百万円となっております。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	2,628百万円	3,208百万円
のれんの償却額	169百万円	169百万円